

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

## 北京金证互通资本服务股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、对外投资概述

## (一) 基本情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“金证互通”、“公司”）与北京金证投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金证投资”），拟共同投资北京市辰至半导体科技有限公司（以下简称“辰至半导体”、“标的公司”）。本次公司拟以自有资金 3,500 万认购标的公司新增注册资本人民币 82.94 万元，投资完成后，公司持有辰至半导体股权 23.3333%；金证互通及金证投资合计持有辰至半导体股权 36.7998%。

辰至半导体成立于 2023 年，主要从事高性能车规芯片的研发设计，研发产品可广泛应用于汽车的中央融合网关、跨域融合、域控场景等。随着全球科技革命和产业变革的加剧，半导体等核心底层技术决定了新能源汽车、低空经济等产业的发展升级。伴随新能源汽车及低空飞行器对智能化、网联化要求的快速提升，以及国家对核心技术自主可控的强要求，高端车规级芯片的国产化、定制化具备很大的发展潜力。公司围绕国家战略及产业规划，深入挖掘和把握这一领域的投资机会，同时，考虑到公司深耕资本市场投资者关系服务，本次投资将有助于公司对于汽车生态、芯片领域的深度理解，有利于促进相关产业中信息、业务、资源等有效对接及高效利用。

截至公告披露日，公司于 2024 年 8 月 9 日与辰至半导体、及昱科技、司征科技、及风科技、刘桂江、司昌科技、梁洪崑、栖港愿景、金证投资签署了《关于北京市辰至半导体科技有限公司之投资协议》。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第四十条：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次投资金证互通拟出资 3,500 万元，投资后持有辰至半导体股权 23.3333%；金证互通及金证投资合计持有辰至半导体股权 36.7998%。根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京市辰至半导体科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（中瑞咨报字【2024】第 301330 号），截止 2023 年 12 月 31 日，被投资企业辰至半导体资产总额 2,219.86 万元，净资产额为 1,918.80 万元。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 166,821,124.48 元，净资产额为 88,345,988.32 元。本次投资 3,500 万元，占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 20.98%和 39.62%，未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。金证互通、金证投资实际控制人为陈斌。本次投资前，金证投资持有辰至半导体股权 4.3478%，本次投资后，金证投资持有辰至半导体股权 13.4665%。

### （四）审议和表决情况

2024 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述交易构成关联交易，关联董事陈斌回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及新领域。辰至半导体所属行业为信息技术中的半导体和软件服务业，主要从事 ASIL-D 级车规芯片的研发设计，产品以 ASIL-D 级 MPU/MCU 为主，可应用于中央融合网关、跨域融合、域控场景等。近年来，国内新能源汽车产业已经实现跨越式发展，新能源汽车产业的竞争由电动化向智能化转变、由国内市场竞争向全球市场竞争转变。其中，汽车芯片及其解决方案是汽车产业链的关键技术，是汽车智能化和网联化发展的基石、是实现自主可控、打造全球领先产业地位的重要前提。

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京金证投资管理中心（有限合伙）

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 9 层 906

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 9 层 906

注册资本：5,000 万元

主营业务：投资管理；资产管理。

控股股东：陈斌

实际控制人：陈斌

关联关系：陈斌系金证互通、金证投资实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

## （一）投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

公司拟以自有资金 3,500 万认购辰至半导体新增注册资本人民币 82.94 万元。

此次增资为单方面增资，主要基于公司认为新能源汽车产业发展中，对于中国经济发展有着重要战略意义，而芯片作为实现汽车智能化、网联化和电动化的重要基础，已成为未来汽车产业进步的关键因素之一。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：北京市辰至半导体科技有限公司

成立时间：2023 年 3 月 22 日

注册资本：230 万人民币

统一社会信用代码：91110111MACDRL7G0T

法定代表人：刘左娥

注册地址：北京市房山区弘安路 87 号院 5 号楼 2 层 245 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；专业设计服务；集成电路销售；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发。

#### 1、标的公司主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,219.86	884.77
净资产	1,918.80	180.11
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,162.20	-1,806.46

辰至半导体 2023 年度（经审计）及 2024 年半年度（未经审计），审计机构为：北京博宸益恒会计师事务所（普通合伙），出具了无保留意见的《审计报告》（博宸益恒审字【2024】第 002544 号）。

#### 2、本次投资完成前，目标公司的股权结构如下：

投资方名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
北京及昱科技合伙企业（有限合伙）	货币	64.00	27.8261%
北京及风科技合伙企业（有限合伙）	货币	40.00	17.3913%

昆明司征科技有限公司	货币	40.00	17.3913%
刘桂江	货币	30.00	13.0435%
昆明司昌科技合伙企业（有限合伙）	货币	16.00	6.9565%
嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	14.00	6.0870%
梁洪崑	货币	10.00	4.3478%
北京金证投资管理中心（有限合伙）	货币	10.00	4.3478%
北京天使极融投资管理中心（有限合伙）	货币	6.00	2.6087%
<b>合计</b>		<b>230.00</b>	<b>100.00%</b>

3、本次投资完成后，目标公司的股权结构如下：

投资方名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例
北京及昱科技合伙企业（有限合伙）	货币	64.00	18.0055%
北京及风科技合伙企业（有限合伙）	货币	40.00	11.2535%
昆明司征科技有限公司	货币	40.00	11.2535%
刘桂江	货币	30.00	8.4401%
昆明司昌科技合伙企业（有限合伙）	货币	16.00	4.5014%
嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	17.25	4.8531%
梁洪崑	货币	10.00	2.8134%
北京金证投资管理中心（有限合伙）	货币	47.87	13.4665%
北京天使极融投资管理中心（有限合伙）	货币	7.39	2.0799%
北京金证互通资本服务股份有限公司	货币	82.94	23.3333%
<b>合计</b>	货币	<b>355.45</b>	<b>100.0000%</b>

（注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，系四舍五入原因所致）

4、评估说明

本次投资标的价值评估，以2023年12月31日为估值基准日，本次估值选用的估值方法为：收益法。由中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京市辰至半导体科技有限

公司股东全部权益价值估值报告》（中瑞咨报字【2024】第 301330 号）。

选取收益法评估的理由：公司为汽车半导体研发企业，目前主要从事 ASIL-D 级车规芯片的研发设计业务。经评估人员现场调查，该企业成立于 2023 年 03 月 22 日，已于 2024 年 03 月 14 日取得《中关村高新技术企业》证书，公司初创团队较为成熟，多数成员已于相关行业耕耘多年，有较为成熟的技术优势以及比较详细的经营计划，未来收益可以合理预测，根据汽车半导体研发收益和风险情况，结合北京市辰至半导体科技有限公司的自身状况分析，可以比较合理地估算折现率，可以采用收益法进行评估。

北京市辰至半导体科技有限公司主营产品属于智能汽车领域处于领先地位的产品，产品技术壁垒高、行业稀缺、有较高的定价权，叠加成本优势，盈利能力强。收益法很好地体现公司未来的获利能力，因此，本次评估采用收益法的估值结论。

#### 收益法估值结果

北京市辰至半导体科技有限公司于估值基准日总资产账面价值 2,219.85 万元，负债账面价值 301.06 万元，股东全部权益账面价值 1,918.79 万元，评估价值为 13,442.70 万元，评估增值 11,523.91 万元，增值率 600.58%。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

## （八） 定价情况

本次交易定价遵循公平、公开、公允的原则，公司本次拟以增资形式投资人民币 3,500 万元，以每一元注册资本 42.20 元人民币对价，认缴辰至半导体新增注册资本 82.94 万元。本次交易为关联交易，本次增资主要依据：1、辰至半导体财务情况；2、产品研发进展、后续产品发展规划及盈利预测；3、目前股权投资市场同行业的可比企业估值；4、结合中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京市辰至半导体科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（中瑞咨报字【2024】第 301330 号），进行综合定价。本次增资不存在因关联交易影响交易定价的特殊事项。

## （九） 对外投资协议的主要内容

## 1、增资金额

根据《投资协议》：（1）金证互通、金证投资分别以人民币 3,500 万元和 1,500 万元的价款认购辰至半导体新增注册资本人民币 82.94 万元和 35.54 万元；（2）由于本轮投资价格低于天使轮投资价格，触发了天使轮股东协议中关于反稀释调整的约定，按照该约定，天使轮投资人栖港愿景、金证投资、天使极融分别无偿取得辰至半导体以资本公积定向转增的注册资本人民币 3.25 万元、人民币 2.32 万元和人民币 1.39 万元；（3）本次整体交易完成后，辰至半导体的注册资本将本由人民币 230 万元增加至人民币 355.45 万元。

## 2、增资款的支付、用途

公司在本协议约定的交割条件全部得以满足或由投资人书面豁免的情况下将增资认购款支付至标的公司银行账户。

增资价款可用于补充辰至半导体的流动资金、人员开支、研发和其他标的公司正常运营支出，以及根据辰至半导体公司章程经董事会或股东会批准的其他用途等；未经投资人书面同意，增资价款不得用于回购股份、购买债券或者证券。

## 3、生效

本协议经各方签字、盖章后成立，除本条以及与适用法律和争议的解决、保密等相关的条款自本协议文首载明签署日起生效外，本协议其他条款自本协议第 3 条约定的先决条件全部成就之日起生效。本协议未尽事宜，经各方协商一致后，可另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。未经投资人事先书面同意，现有股东无权向任何第三方转让或以其他方式处置其在本协议项下的权利或义务。

## 4、适用法律

本协议的订立、有效性、解释、签署以及与本协议有关的一切争议的解决均应受中国法律的管辖，并据其进行解释。

## （十）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资事项符合国家相关产业政策。随着全球科技革命和产业变革的加速，在当前人工智能、芯片等技术的快速发展下，新能源汽车产业的发展中，芯片作为实现汽车智能化、网联化和电动化的重要基础，已成为未来汽车产业进步的关键因素之一，而在低空经济领域中，飞行汽车作为核心产品之一，被业界广泛视为新型生产力的典范，飞行汽车

在动力、飞控、空中自驾及飞行安全等方面要求更高，对高端车规级芯片的需求会带来较大的发展潜力。公司围绕国家战略及产业规划，深入挖掘和把握这一领域的投资机会，同时，公司深耕资本市场投资者关系服务，将有助于公司对于汽车生态、芯片及人工智能领域的深度理解，有利于促进相关产业中信息、业务、资源等有效对接及高效利用。

## （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发，作出的慎重决策，有利于提高公司综合实力，加深公司在服务半导体领域、新能源汽车领域、低空经济领域公司的理解，提高公司在服务相关行业客户的服务深度及积极影响。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。同时，公司将持续关注标的公司所处行业的外部环境、市场变化，不断提升标的公司的内部管理水平 and 市场拓展能力，以积极防范和应对可能面临的不确定因素。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资事项符合国家相关产业政策，是公司基于未来整体战略发展做出的决策，预计将对公司的中长期发展产生积极影响，且不会对公司的财务状况产生重大影响，预计将对公司的经营成果具有积极影响。

## （十一）备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024年8月9日